

UNDERFILL 688 DE UN PASO

CARACTERÍSTICAS

- Combina el curado bajo relleno y el proceso de reflujo de soldadura
- Compatible con residuos de flux No-Clean
- Flux y underfill de un paso
- Requiere un perfil de reflujo de aleación sin Pb
- Mejora significativamente el rendimiento mecánico

DESCRIPCIÓN

Underfill 688 de un paso es una resina epoxi monocomponente de baja tensión superficial diseñada como underfill de un solo paso para ensamblajes flip chip, CSP, BGA y micro-BGA. Underfill 688 de un paso contiene un agente de flux, eliminando la necesidad de pasta de soldadura con componentes con protuberancias. También elimina la necesidad de un paso separado de dispensación y curado de epoxi tras el reflujo de soldadura. Mejora la prueba de impacto y el rendimiento mecánico con una T_g alta y un CTE bajo, con este underfill de bajo nivel de vacíos. 688 es compatible con los residuos de pasta de soldadura AIM o flux líquido, así como con los acabados superficiales habituales.

PROPIEDADES FÍSICAS

Parametro	Resultados
Apariencia	Morado cuando no está curado, transparente cuando está curado
Gravedad específica @ 25°C	1.27 g/cc típico
Volátiles totales	< 1% típico
Viscosidad (Brookfield)	300 cps típico
T _g	64.1°C típico
CTE (before T _g)	62.7 ppm típico
CTE (after T _g)	174.6 ppm típico

MANEJO Y ALMACENAJE

Parametros	Tiempo	Temperatura
Conservación en congelador	3 meses	< -20°C (-4°F)
Vida útil en refrigeración	2 meses	5°C (41°F)
Vida útil sin refrigeración	1 semana	25°C (77 °F)

No almacenar cerca del fuego o llamas. Mantener alejado de la luz solar ya que puede degradar el producto.

APLICACIÓN

Imprime pasta de soldadura sin Pb. Dispensar Underfill 688 de un paso sobre la PCB donde se colocarán los puntos de soldadura. La pasta de soldar NO debe aplicarse en estas zonas. Coloque todos los componentes. DEBE curarse en un perfil de soldadura sin Pb, temperatura máxima 255°C (491°F). Asegúrese de que todos los pads están cubiertos con Underfill 688 de un paso. Underfill 688 de un paso puede ser retrabajado. Calentar el componente a la temperatura de reflujo de soldadura y retirarlo con una espátula plana. Se puede utilizar una mecha de soldar y un soldador para eliminar el epoxi residual. Limpie los pads con una pequeña cantidad de disolvente, como metiletilcetona o alcohol isopropílico. Underfill 688 de un paso se ablanda a 120°C - 140°C (248°F - 284°F).

SEGURIDAD

Utilícese con ventilación adecuada y equipo de protección personal apropiado. Consultar la Ficha de Datos de Seguridad para cualquier información específica de emergencia. No deseche ningún material peligroso en recipientes no aprobados. No conforme con REACH.

*Toda la información es solo como referencia. No se debe utilizar como especificaciones de productos entrantes o para diseño de procesos. Consulte el Certificado de análisis para obtener información específica del producto.

CONDICIONES DE USO La información aquí contenida se basa en datos considerados como precisos y se ofrece sin cargo alguno. La información sobre el producto se basa en el hecho de asumir que el manejo y las condiciones de operación son los adecuados. No se acepta responsabilidad por pérdidas o lesiones que provengan del uso de esta información o de alguno de los materiales designados. Refiérase a <http://www.aimsolder.com/terms-conditions> para revisar términos y condiciones de AIM.